

无锡泰连芯科技有限公司

TLX2274 型

4:1 高速 USB 多路复用器/开关

2024 年 06 月

4:1 高速 USB 多路复用器/开关

1 特点

- 带宽宽: **550MHz**
- 供电电压 **+2.5V 至 +4.4V**
- 低导通电阻, **3.3V** 时为 **6Ω** (典型值)
- 控制输入的 **1.8V** 逻辑阈值兼容性
- 轨对轨运营
- 快速切换时间
- 工作温度范围:
-55°C 至 125°C
- 封装: **UQFN2.6X1.8-16**

2 应用

- 路由 **USB 1.0、1.1** 和 **2.0** 信号
- **MP3** 和其他个人媒体播放器
- 移动 **POS** 和便携式 **POS**
- 显示面板的 **USB** 开关

3 描述

TLX2274 是一款双向、低功耗、高速 **USB 2.0** 开关, 由两个 **4:1**多路复用器组成。**TLX2274** 具有极低的导通电阻, 允许输入连接到输出, 而不会增加传播延迟。它经过优化, 可从四个高速 (**480Mbps**) 源或任意高速和全速/低速 **USB/UART** 源组合切换到一个 **USB 2.0** 连接器。

TLX2274 采用绿色 **UQFN2.6X1.8-16** 封装。其工作环境温度范围为 **-55°C 至 125°C**。

质量等级:军温级&N1级

设备信息 ⁽¹⁾

产品编号	封装	主体尺寸 (标称)
TLX2274	UQFN2.6X1.8-16	2.60mm×1.80mm

(1) 对于所有可用的封装, 请参阅数据表末尾的可订购附录。

目录

1 特点 2

2 应用 2

3 描述 2

4 修订历史 4

5 封装/订购信息⁽¹⁾ 5

6 逻辑函数 6

7 引脚配置 7

8 规格 8

 8.1 绝对最大额定值 8

 8.2 ESD 额定值 8

 8.3 建议工作条件 8

 8.4 直流电气特性 9

 8.5 交流电气特性 10

9 参数测量信息 11

10 包装外形尺寸 13

11 卷带信息 14

4 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	变更日期	更改项目
A.0	2024/05/17	初步版本完成
A.0.1	2024/05/20	1.修改特性、应用和描述 2.修改PIN码说明 3.添加UQFN2.6X1.8-16焊盘图案
A.1	2025/01/06	初始版本完成
A.2	2025/02/11	删除 QFN3X3-16 封装

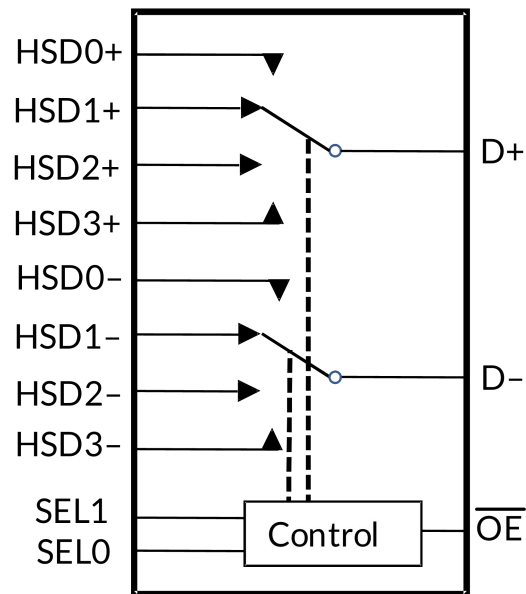
5 封装/订购信息⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	丝印标记 ⁽²⁾	MSL	质量等级
JTLX2274XTQQ16	-55 °C ~+125 °C	UQFN2.6X1.8-16	2274	MSL1/3	N1/军温级
TLX2274XTQQ16	-40 °C ~+125 °C	UQFN2.6X1.8-16	2274	MSL1/3	工业级

笔记:

- (1) 此信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，亦不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航栏。
- (2) 可能有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 在其组装工厂内使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置来划分 MSL 等级。如果您的最终应用对预处理设置要求严格，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 协商。

6 逻辑函数

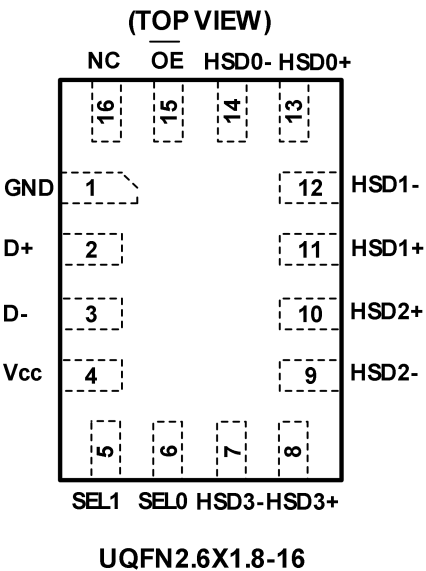


功能表

OE	SELO	SEL1	功能
1	X	X	D+、D- 开关路径打开
0	0	0	D+ = HSD0+, D- = HSD0-
0	1	0	D+ = HSD1+, D- = HSD1-
0	0	1	D+ = HSD2+, D- = HSD2-
0	1	1	D+ = HSD3+, D- = HSD3-

X=不在乎
笔记： 输入和输出引脚相同且可互换。两者都可以视为输入或输出；信号在两个方向上传输效果相同。

7 引脚配置



引脚描述

代码	引脚	功能
	UQFN2.6X1.8-16	
D+	2	D+ 公共端口
D-	3	D- 公共端口
HSD0+	13	D+来自第一个源路径
HSD0-	14	D- 来自第一个源路径
HSD1+	11	D+来自第二个源路径
HSD1-	12	D-来自第二个源路径
HSD2+	10	D+来自第三个源路径
HSD2-	9	D-来自第三个源路径
HSD3+	8	D+来自第四个源路径
HSD3-	7	D-来自第四个源路径
GND	1	接地
Vcc	4	电源
OE	15	启用控制引脚，拉低启用该设备
SEL1	5	数字控制引脚
SEL0	6	数字控制引脚
NC	16	无连接

笔记:

1. 该模拟开关没有方向性，每个端口都可以作为输入或者输出。

8 规格

8.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内(除非另有说明) ⁽¹⁾

代码	范围		最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压		-0.5	5.25	V
V _{CNTRL}	直流输入电压 (SEL1、SEL0、 \overline{OE} 、SELS) ⁽²⁾		-0.5	V _{CC}	V
V _{SW}	直流开关输入/输出电压 ⁽¹⁾		-0.5	5.25	V
I _{IK}	直流输入二极管电流		-30		mA
θ _{JA}	封装热阻 ⁽³⁾	UQFN2.6X1.8-16		150	°C/W
T _{STG}	储存温度		-65	150	°C

- (1) 超过这些额定值的应力可能会造成永久性损坏。长时间暴露于绝对最大条件可能会降低器件的可靠性。这些仅为应力额定值，并不保证器件在这些或任何其他超出规定值的条件下能够正常工作。
- (2) 设备所有未使用的数字输入必须保持在 V_{CC}或 GND，以确保设备正常运行。
- (3) 封装热阻按照JESD-51计算。

8.2 ESD 额定值

以下 ESD 信息仅适用于 ESD 保护区内 ESD 敏感设备的处理。

代码	范围		数值	单位
静电放电 (ESD)	IEC61000-4-2 USB 连接器系统或引脚 D+ 和 D- 人体模型, JEDEC: JESD22-A114	接触	±8	千伏
		D +、D-接GND	±7	
		电源至GND	±7	
		所有其他引脚	±4	
	充电器件模型 (CDM), ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018		±1000	五
	机械模型(MM), JESD22-A115C (2010)		±200	



ESD 敏感度警告

ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为即使很小的参数变化也可能导致器件不符合其公开的规格。

8.3 建议工作条件

在自然通风工作温度范围内(除非另有说明)

代码	范围	最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压	2.5	4.4	V
V _{CNTRL}	控制输入电压 (SEL1、SEL0 \overline{OE} 和 SELS)	0	V _{CC}	V
V _{SW}	开关输入/输出电压	-0.5	4.4	V
T _A	工作温度	-55	125	°C

8.4 直流电气特性

除非另有说明，所有典型值均为 $V_{CC}=3.3V$ ， $25^{\circ}C$ 时的典型值。FULL = $-55^{\circ}C - 125^{\circ}C$ 。

范围	代码	状况	V_{CC} (V)	T_A	最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
导通电阻	$R_{ON}^{(1)}$	$V_{SW} = 0.4V, I_{ON} = 8mA$, Figure 1	3.3	25°C		6	7	Ω
				FULL			9	
通道间的导通电阻匹配	ΔR_{ON}	$V_{SW} = 0.4V, I_{ON} = 8mA$	3.3	25°C		0.34	0.5	Ω
				FULL			0.6	
控制输入泄漏	I_{IN}	All Combinations of \overline{OE} SEL1 & SEL0 in the Truth Table (1= V_{CC} , 0=0V)	4.4	FULL	-1		1	μA
断态泄漏	I_{OZ}	0 \leq Dn, HSD0n, HSD1n, HSD2n, HSD3n \leq 4.4V	4.4	FULL	-1		1	μA
断电漏电流 (所有 I/O 端口)	I_{OFF}	$V_{SW} = 0V$ to 4.4V, Figure 2	0	FULL	-1		1	μA
睡眠模式电源电流	I_{CCSLP}	$\overline{OE} = V_{CC}$	4.4	FULL			1	μA
有源模式电源电流	I_{CCACT}	All Active Modes in Truth Table	4.4	FULL		8	16	μA
cc 电流和 V_{CC} 增加	I_{CCT}	$V_{CNTRL} = 1.8V$	4.4	FULL			3.5	μA
		$V_{CNTRL} = 1.2V$	4.4	FULL			4	μA
钳位二极管电压	V_{IK}	$I_{IN} = -18mA$	2.5	FULL			-1.2	V
控制输入电压高	V_{IH}	SEL1, SEL0, \overline{OE}	2.5 to 4.4	FULL	1			V
控制输入电压低	V_{IL}	SEL1, SEL0, \overline{OE}	2.5 to 4.4	FULL			0.35	V

(1) 测量 HSDn 和 Dn 引脚之间的电压降。导通电阻由两个 (HSDn 或 Dn 端口) 上的较低电压决定。

(2) 限值在 $25^{\circ}C$ 下经过 100% 生产测试。工作温度范围内的限值通过统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保。

(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间变化，并取决于应用和配置。

8.5 交流电气特性

除非另有说明，所有典型值均为 $V_{CC}=3.3V$ ， $25^{\circ}C$ 时的典型值。FULL = $-55^{\circ}C - 125^{\circ}C$ 。

范围	代码	状况	T_A	最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
从一个 USB 路径（或禁用 $\overline{OE}=1$ ）切换到另一个 USB 路径时的开启时间	t_{ON}	$R_L=50\Omega$, $C_L=35pF$, $V_{SW}=0.8V$, Figure 3, Figure 4	$25^{\circ}C$		200		μs
关闭时间，关闭任何 USB 路径	t_{OFF}	$R_L=50\Omega$, $C_L=35pF$, $V_{SW}=0.8V$, Figure 3, Figure 4	$25^{\circ}C$		92		ns
传播延迟 ⁽¹⁾	t_{PD}	$C_L=5pF$, $R_L=50\Omega$, Figure 3, Figure 5	$25^{\circ}C$		0.35		ns
慢速开启/关闭开关路径 ⁽¹⁾	t_{RF}	$C_L=5pF$, Dn at 0V or 3.6V, 40.5 Ω in series with switch 10% to 90%	$25^{\circ}C$		4.5		ns
先断后合时间	t_{BBM}	$R_L=50\Omega$, $C_L=35pF$, $V_{SW1}=V_{SW2}=0.8V$, Figure 7	$25^{\circ}C$		200		μs
-3dB 带宽	BW	$R_L=50\Omega$, $C_L=5pF$, Figure 8	$25^{\circ}C$		550		MHz
隔离	O_{IRR}	$R_L=50\Omega$, $f=240MHz$, Figure 9	$25^{\circ}C$		-40		dB
通道间串扰	X_{talk}	$R_L=50\Omega$, $f=240MHz$, Figure 10	$25^{\circ}C$		-40		dB
脉冲偏移 ⁽¹⁾	$t_{SK(P)}$	$V_{SW}=0.2V_{diffPP}$, $C_L=5pF$, Figure 6	$25^{\circ}C$		25		ps
一对差分信号之间的偏差 ⁽¹⁾	$t_{SK(I)}$	$V_{SW}=0.2V_{diffPP}$, $C_L=5pF$, Figure 6	$25^{\circ}C$		25		ps
输入电容	C_{IN}	$f=1MHz$, $V_{IN}=0$ to V_{CC}	$25^{\circ}C$		3		pF
D+/D- 导通电容	C_{ON}	$f=1MHz$, $V_{IN}=0$ to V_{CC}	$25^{\circ}C$		11.5		pF
HSD0n 、 HSD1n 、 HSD2n 、 HSD3n 关断电容	C_{OFF}	$f=1MHz$, $V_{IN}=0$ to V_{CC}	$25^{\circ}C$		2.8		pF

(1) 此参数由设计和/或特性确保，并未在生产中测试。

(2) 限值在 $25^{\circ}C$ 下经过 100% 生产测试。工作温度范围内的限值通过统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保。

(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间变化，并取决于应用和配置。

9 参数测量信息

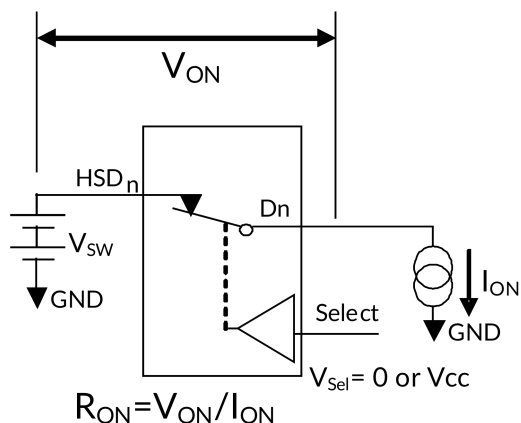
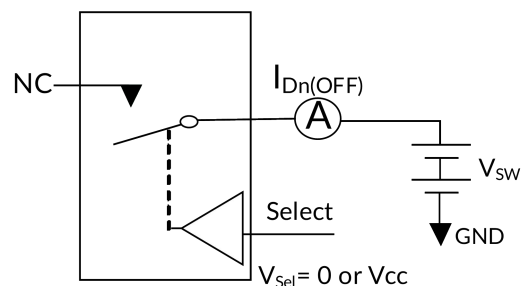
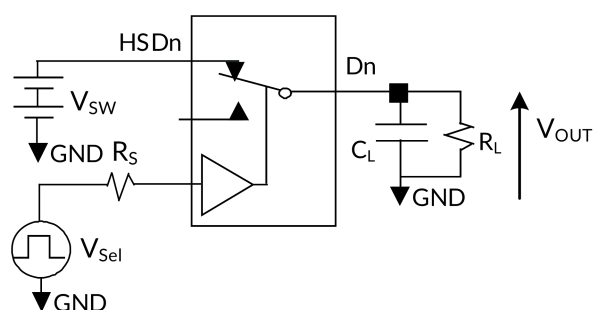


图 1. 导通电阻



**Each switch port is tested separately

图 2. 关断漏电



R_L , R_S and C_L are functions of the application environment (see AC Tables for specific values)
 C_L includes test fixture and stray capacitance.

图 3. 交流测试电路负载

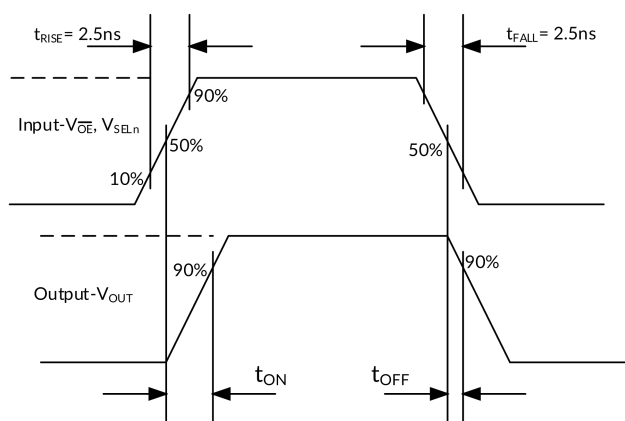


图 4. 开启/关闭波形

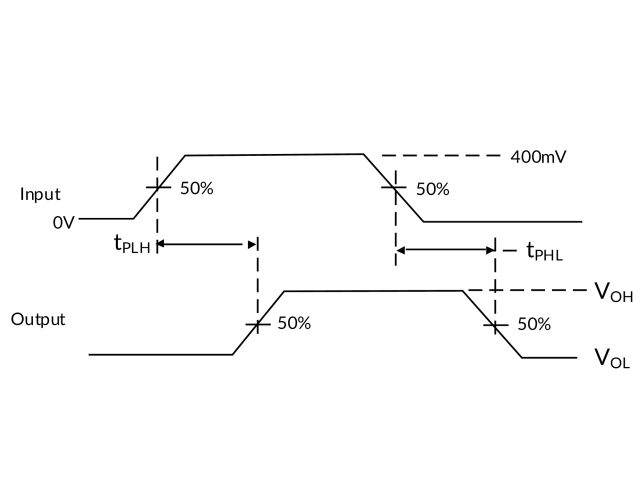
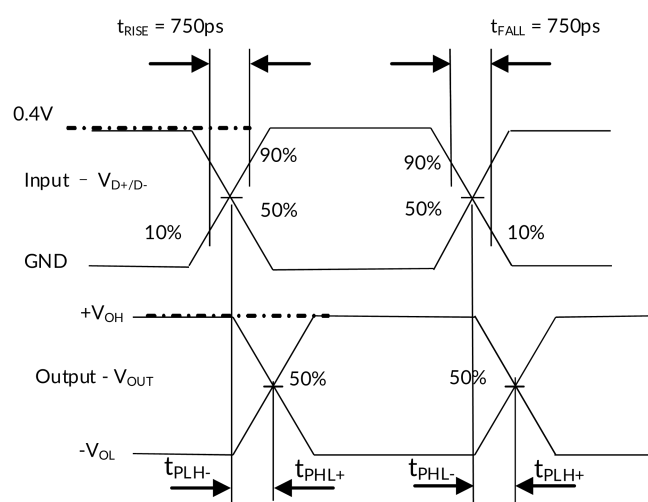
5. 传播延迟 ($t_{r}t_f - 500ps$)

图 6. 偏移测试波形

$$t_{SK(P)} = |t_{PLH-} - t_{PHL-}| \text{ or } |t_{PLH+} - t_{PHL+}|$$

$$t_{SK(I)} = |t_{PLH-} - t_{PHL+}| \text{ or } |t_{PLH+} - t_{PHL-}|$$

参数测量信息（续）

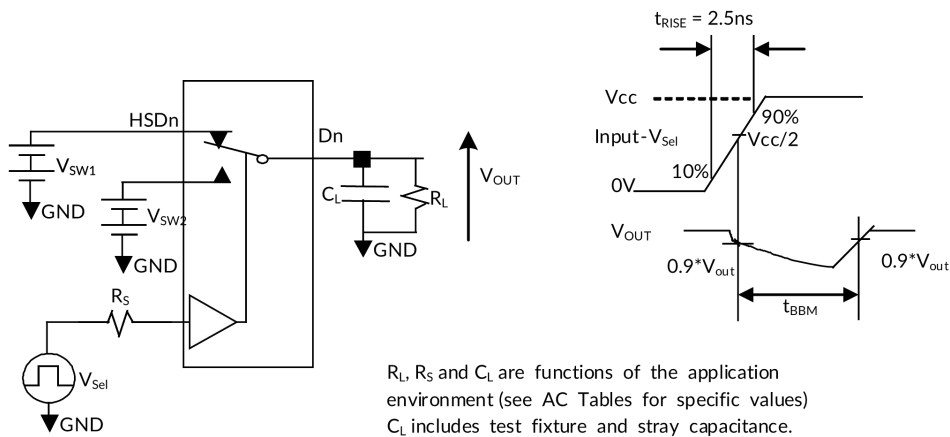


图 7. 先断后通间隔时序

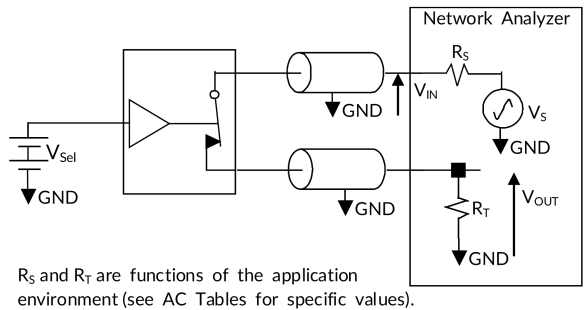


图 8. 带宽

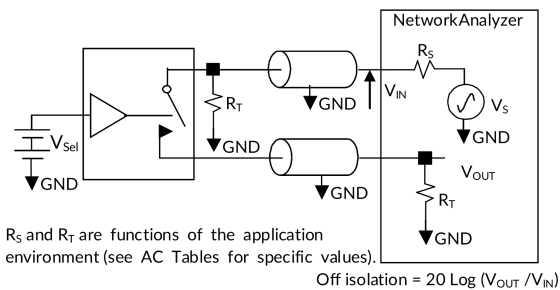


图 9. 通道关闭隔离

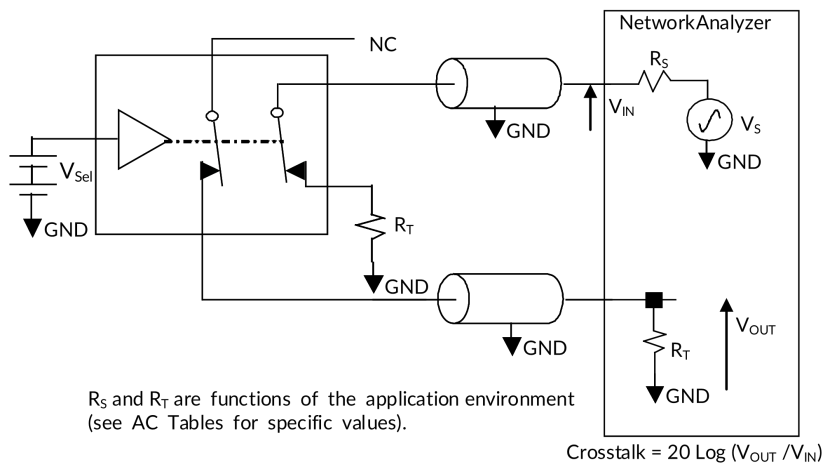


图 10. 非相邻通道间串扰

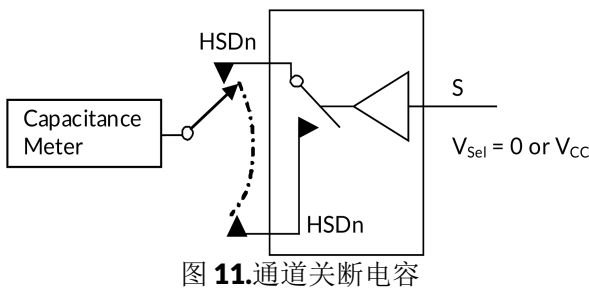


图 11. 通道关断电容

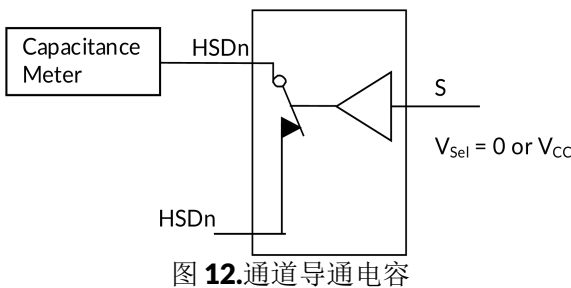
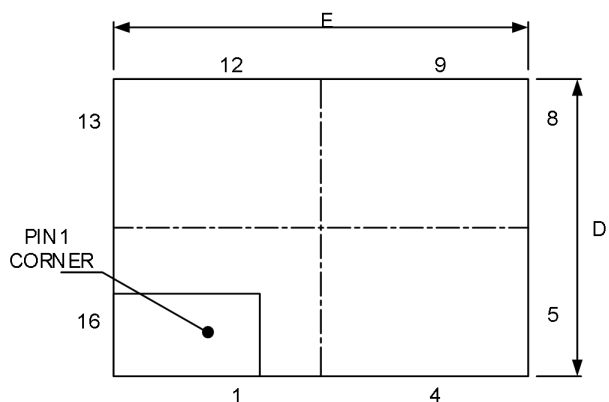


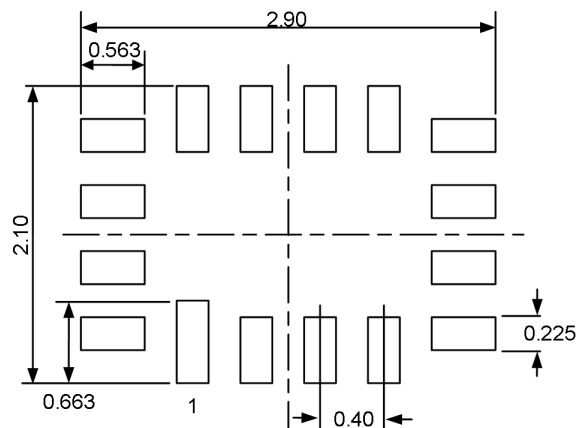
图 12. 通道导通电容

10 包装外形尺寸

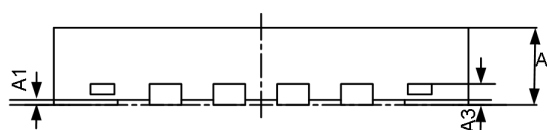
UQFN2.6X1.8-16⁽³⁾



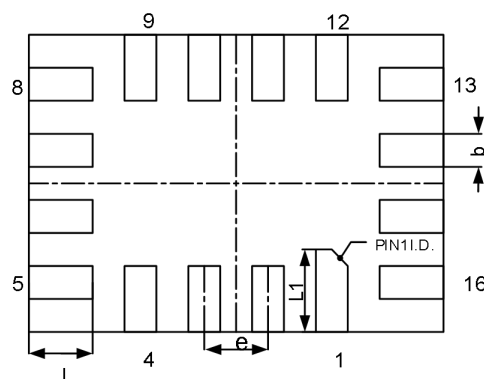
TOP VIEW



RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



SIDE VIEW



BOTTOM VIEW

代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A⁽¹⁾	0.450	0.550	0.018	0.022
A1	0.000	0.046	0.000	0.002
A3	0.110 (REF)⁽²⁾		0.004 (REF)⁽²⁾	
b	0.150	0.250	0.006	0.010
E⁽¹⁾	2.550	2.650	0.100	0.104
D⁽¹⁾	1.750	1.850	0.069	0.073
e	0.400 (TYP)		0.016 (TYP)	
L	0.350	0.450	0.014	0.018
L1	0.450	0.550	0.018	0.022

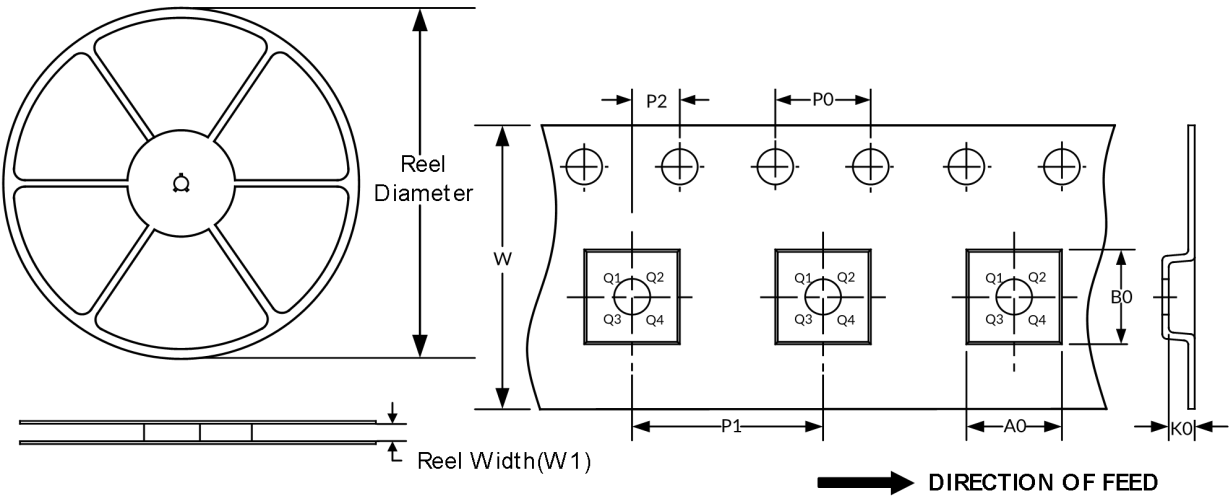
笔记:

1. 不包括每侧最大 **0.075** 毫米的塑料或金属突出物。
2. REF 是 Reference 的缩写。
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

11 卷带信息

卷轴尺寸

胶带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带封装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷轴宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
UQFN2.6X1.8-16	7"	8.3	2.10	2.90	0.75	4.0	4.0	2.0	8.0	Q1

笔记:

- 1. 所有尺寸均为标称尺寸。
- 2. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。